

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2023-07-050

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2023年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2023年1月1日至2023年6月30日

2、预计的经营业绩：同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：1,600万元 - 2,000万元	盈利：35,943.16万元
	比上年同期下降：94.44%-95.55%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：510万元 - 710万元	盈利：27,122.02万元
	比上年同期下降：97.38%-98.12%	
基本每股收益	盈利：0.0095元/股 - 0.0118元/股	盈利：0.24元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司业绩较去年同期变动的主要原因如下：

1、受国际政治经济环境变化等因素影响，公司面临行业景气度下行、需求低迷、竞争加剧等负面冲击，导致2023上半年营业收入同比下降、盈利能力下滑。

2、公司持续推进封装基板业务的投资扩产，并加大人才引进力度和研发投

入，成本费用负担较重，对净利润造成较大拖累，其中：

（1）FCBGA封装基板业务持续推进投资扩产，上半年人工、材料、能源、折旧等费用合计约1.46亿元，整体亏损约1.09亿元；

（2）公司控股子公司广州兴科半导体有限公司的CSP封装基板项目于2022年第三季度进入量产，因行业需求大幅下滑导致产能利用率较低，上半年亏损约4,256万元，影响归属于上市公司股东的净利润约2,170万元；

（3）上半年员工持股计划费用摊销约1,530万元。

四、风险提示

本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司2023年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十四日